

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<u>2024年10月30日</u> JK Capital Management Limited、华商基金、汇安基金、嘉实基金、景林资产、太平洋资产管理、中意资产管理等 <u>2024年10月31日</u> 公开业绩说明会
时间	2024年10月30日、2024年10月31日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器

IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

2024 年第二季度，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况

	<p>快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。在此基础上，公司 2024 年第三季度保持经营改善的趋势，单季度营业收入同环比均实现两位数增长，第三季度实现营业收入 7.18 亿元，环比增长 16.96%，同比增长 23.60%。</p> <p>公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，2024 年第三季度新签订单 6.48 亿元，在手订单已连续四季度保持高位，截至 2024 年三季度末在手订单为 21.38 亿元，其中一年内转化为收入的比例为 78.26%。公司订单情况良好，为未来的业绩转化奠定坚实基础。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司知识产权授权使用费收入中，AI 算力相关收入主要来自于哪些 IP？</p> <p>回复：针对日益增长的支撑 AIGC 应用的海量算力需求，公司推出了面向高性能计算的 AI GPU IP、高性能 GPU IP 和 GPGPU IP 等，极大地丰富了公司的 AI 计算技术储备。目前，芯原的处理器 IP 系列产品能够满足多样的人工智能计算需求，在 2024 年前三季度，公司与 AI 算力相关的知识产权授权使用费收入 2.32 亿元，占比 48.59%，其中主要为公司 GPU IP、NPU IP 等。</p> <p>问题：请问公司先进制程芯片设计项目主要分布在哪些领域？</p> <p>回复：在一站式芯片定制服务方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现 5nm SoC 一次流片成功，多个 4nm/5nm 一站式服务项目正在执行。在 2024 年前三季度，公司实现芯片设计业务收入 5.18 亿元，同比增长 37.02%，其中 14nm 及以下工艺节点收入占比为 86.22%，主要分布于数据中心、自动驾驶、计算机及周边等领域。</p>

问题：公司在行业整合方面有一定优势，在当前行业周期下行背景下，是否有更多潜在的并购机会？

回复：半导体的发展有正常的波动周期，产业下行时期是半导体 IP 行业整合的良好时机。作为半导体 IP 和一站式芯片定制服务平台的行业龙头，芯原非常适合做并购。芯原多年以来一直坚持以内部自主研发为主，在自主创新的同时适时对芯原所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新，在此过程中，芯原的 IP 得到了充实，芯片定制能力也逐渐变强。未来，公司将继续依托平台化公司的行业理解，积极推进产业生态建设，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购公司，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

问题：请问如何展望公司未来业绩情况？

回复：2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特商业模式的优势，没有产品库存风险，没有应用领域的边界，2024 年二季度起，公司经营情况快速扭转。2024 年二季度，公司收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度，公司营业收入创历年三季度收入新高，公司收入连续两个季度改善，体现公司收入受行业下行周期影响较晚，收入恢复增长较早的特点。

公司 2024 年三季度末在手订单金额为 21.38 亿元，在手订单已连续四季度保持高位，2024 年三季度末在手订单预计一年内转化为收入的比例为 78.26%，为未来的业绩转化奠定坚实基础。

问题：请问公司如何看待目前行业的竞争？

回复：公司将从如下方面持续强化自身的核心竞争力，以保障可持续发展，提升业绩：1)面向目标市场如 AIGC、ADAS 和自动驾驶、AR

眼镜等智慧可穿戴设备，以及数据中心等领域，持续丰富和优化半导体 IP、IP 子系统和 IP 平台，保持有利的市场地位；2) 夯实从硬件到软件的系统设计能力，以满足日益增长的大型互联网企业、云服务提供商等非芯片客户的需求；3) 强化在 Chiplet 领域的先发优势，深度布局面向 AIGC 和智驾系统的高性能计算和异构计算；4) 充分利用公司半导体 IP 授权服务和一站式芯片定制服务的协同效应，以及灵活的业务模式，深化和重要客户的合作深度，并拓展如 AI Pad，AR 眼镜等增量市场的客户合作广度；5) 持续高研发投入以打造高竞争壁垒；6) 坚持引进和培养优秀人才，以强化公司的软实力。